



## 性能指标

|         |  |
|---------|--|
| 通用特性    | 28nm 工艺，<br>尺寸：7mm×5.9mm   |
|         | 工作温度：-40~85℃<br>存储温度：-55~125℃<br>基带射频一体化设计<br>SIP Flash<br>SIP PSRAM（可选）<br>SIP PMIC |
|         |  |
|         |  |
| 主控处理器   | RISC-V，最高主频 600MHz   |
| DSP 处理器 | 最高主频 400MHz  |
| 内存      | 16KB ROM<br>1.5MB On-chip SRAM   |
| 启动模式    | 支持 Flash 程序启动<br>支持 UART 启动<br>支持安全模式，支持 AES/ SHA/ ECC 等安全启动                         |
| 基带调制解调器 | 支持天通卫星通信制式<br>支持 XW 窄带通信制式   |
| 时钟      | 支持系统时钟输入（26MHz/19.2MHz）  |
|         | 支持 32K RTC 时钟输入  |
| 低功耗     | 支持 DRX 低功耗模式   |
| 接口      | USB/UART/GPIO/I2C/SDIO/12S/USIM  |



## 应用领域

HTD3100 芯片体积小、功耗低、集成度高，可适应各种需要。主要面向于大规模应用场景，例如大众消费、汽车、应急救援、低空经济等行业市场，主要支持语音、短信、物联网、数据业务功能。